公司代码:688469 公司简称:芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是□否

报告期公司营业收入81.80亿元,实现25.67%的高速增长;全年毛利率5.51%,同比提升4.48个百分点;归母净利润同比大幅减亏38.17%,亏损收窄至-5.95亿元,盈利能力显著改善。

截至报告期末,公司尚未实现盈利。主要系报告期公司尚处于产线建设初步完成,市场拓展快速增长阶段,产品结构尚未完全优化,规模效益未完全体现。

基于当前强劲的市场需求增长趋势,产品结构的持续优化,碳化硅、模拟IC以及功率模块等高附加值业务占比提升,且随着时间推移设备折旧压力逐步降低,为公司盈利改善提供了核心动力。展望未来,公司将完成从芯片代工到系统级方案提供者的全面升级,实现对汽车、AI服务器、工控及高端消费等关键领域的全覆盖,成为赋能全球新能源与智能化产业的核心力量。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	中芯集成

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	商娴婷
联系地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
电话	0575-88421800	0575-88421800
传真	0575-88420899	0575-88420899
电子信箱	IR@unt-cc.com	IR@unt-cc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要业务为提供系统IC,主要包含应用于车载、AI(人工智能)、工控、高端消费领域的功率(功率器件、功率IC、微控制器等)系统代工和信号链(MEMS传感器\执行器、模拟IC,信号接口等)系统代工。

1、功率系统代工方面

(1)功率器件

功率器件产品包含IGBT、MOSFET、SiCMOSFET芯片及模组,应用于车载、工控、消费、服务器电源等多个应用领域,电压平台覆盖12V-6500V,其中高压功率器件产品主要应用于车载主驱,OBC(车载充电机)、充电桩、风光储、制氢、电力、服务器电源、电机变频驱动等领域。

(2)功率IC和微控制器

功率驱动与控制产品从高电压、大电流和高密度三个维度,提供完善的系统代工服务。其中已成熟量产的0.18um BCD平台,能满足电机驱动等各类驱动、电源管理、接口和AFE(电池管理系统芯片)等终端产品的代工需求;集成单芯片工艺平台BCD 60V/120V+eflash已完成多个客户端的产品验证;第二代90纳米 BCD50V/60V/120V平台已开发完成,配合新能源汽车和工业4.0集成SoC方案,提供高可靠性和更具成本优势的工艺方案;55纳米MCU(嵌入式闪存工艺)平台开发完成,40纳米MCU工艺平台持续开发中。

2、信号链系统代工方面

MEMS等传感信号链产品包含硅麦克风、激光雷达中的微镜和光源VCSEL芯片、压力传感、惯性传感器等。其中应用于高端消费、新能源汽车的第三代麦克风进入量产,第四代麦克风通过初步验证进入产品选代;车载和消费类多轴运动传感器规模量产;车载激光雷达VCSEL芯片大规模量产。

2.2主要经营模式

由于模块化、集成化的市场需求快速凸显,公司在晶圆代工模式的基础上,持续敏锐捕捉市场需求选代趋势。在横向维度上,打造了覆盖设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试环节的一站式系统代工服务体系;在纵向维度上,逐步完成从功率器件、模拟IC,MCU到系统方案的全层级布局,构建起“功率-模拟IC-MCU-系统代工方案”的战略实现路径,全方位满足客户由点到面、从单一芯片到整体应用的全链条代工需求。

基于核心产品线优势,公司能够延伸拓展系统方案能力,形成汽车(包含电驱、电源、电池管理、底盘、热管理、灯、车身控制等)、AI数据中心(电源、光通信等)、工控、高端消费等领域的系统方案全栈通路能力,依托该模式,公司可为不同类型客户提供更高效、灵活、可靠的整体解决方案,通过深度嵌入客户产品开发全流程,实现各环节协同优化,助力客户提升产品可靠性与性能,降低综合成本,缩短产品上市周期,与客户构筑长期稳定的合作伙伴关系。

同时,公司持续优化升级经营策略,不断丰富一站式系统代工服务模式的内涵与外延,重点推进系统方案的研发与落地,进一步提升与客户合作方式的灵活性和多样性,强化全链条服务壁垒,持续增加客户合作黏性。

2.3所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年在新能源汽车普及、智能驾驶渗透、AI算力需求爆发及新能源产业回暖等多重因素驱动下,全球半导体行业在周期性调整后实现强劲复苏,新能源汽车、AI(人工智能)、消费电子、风光储等细分领域需求旺盛,带动功率器件、模拟IC等核心产品保持较快增长,根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2025年全球半导体销售额达7,917亿美元,同比增长25.6%。

中国作为全球最大的汽车、新能源及消费电子市场,其对半导体产品的需求正随着汽车电动化与智能化、人工智能产业等新兴领域的快速发展而持续增长。工信部数据显示,2025年中国集成电路产量达到4,843亿块,同比增长10.9%。海关总署数据显示,2025年中国集成电路出口额约为2,019亿美元,同比增长26.8%。

①新能源汽车赛道需求持续增长,智能化有望加速落地

2025年,中国汽车行业受政策扰动需求有所提升,新能源车市场延续增长态势。根据中国汽车工业协会数据,2025年,中国汽车销量3,440.0万辆,同比增长9.4%,其中新能源汽车销量达1,649.0万辆,同比增长28.2%。乘用车方面,据统计,2025年中国乘用车销量3,010.3万辆,同比增长9.2%,其中新能源乘用车销量1,553.7万辆,新能源乘用车渗透率达51.6%。与此同时,随着智能驾驶数据资源积累,算力、大模型等AI技术的迭代升级,智能驾驶有望从量变到质变,智能化成为当前车企的重要发力点。

功率半导体作为汽车电子的核心,是新能源汽车中成本仅次于电池的第二大核心零部件。新能源汽车市场的持续增长和智能化技术的快速发展,将为功率半导体、模拟IC、传感器等半导体带来广阔增量机遇。

②AI算力驱动数据中心革新升级,第三代半导体和MicroLED迎来广阔发展空间

AI数据中心电源架构,大模型及AI应用的不断涌现和迭代,使得全球算力需求呈现增长态势,数据中心建设规模持续扩大,服务器数量增加,单台服务器机柜功耗不断上升。算力的呈现是电力,AI算力的扩张有望持续推动高功率、高效率和高稳定性的AI服务器电源需求增长,为上游功率、模拟及数模混合芯片产业带来了新的市场机遇。

与此同时,算力规模扩张带来的功耗与散热压力持续提升,对AI数据中心电源核心功率器件的性能提出了革命性要求。在此背景下,以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体功率器件,凭借其优异的高频、高压、低损耗特性,成为适配新一代AI算力基础设施的优选方案。未来随着 AI算力基础设施不断升级,特别是AI数据中心800V/±400V高压直流架构(HVDC)持续演进,固态变压器(SST)逐步实现规模化应用,第三代半导体功率器件市场需求有望迎来快速放量与高速增长。

AI数据中心传输领域,随着人工智能算力需求快速增长,AI数据中心内部传输对更高带宽、更低时延和更高能效的要求日益提升,短距高速光通信技术迎来重要发展机遇。MicroLED光通信方案凭借高集成度、低功耗、高速传输等优势,已成为AI数据中心传输领域的重要新方向,并获得行业头部企业的支持。随着MicroLED光通信方案大规模导入市场及更高带宽方案逐步落地,其需求量有望大幅增长,预计2026-2027年将从实验室研发加速走向产业化应用。

③人形机器人产业化提速,核心器件迎发展新机遇

2025年,中国人形机器人在商业化落地进程中实现突破性进展,核心零部件国产化水平持续提升,量产能力与场景应用逐步成熟,在物流、工业等多个核心场景逐步实现规模化交付。据中国信通院数据,2025年全球人形机器人市场规模达170亿元,中国市场规模突破85亿元,占全球比重超50%。人形机器人从“实验室”走向“大规模商业化”,为传感器、功率半导体及模拟IC等上游核心器件注入强劲增长动能。

④消费电子需求复苏趋势延续,AI(人工智能)赋能打开全新增长空间

当前全球智能手机、PC、家电行业延续需求回暖趋势。据Omdia数据,在3C电子领域,2025年全球智能手机出货量达到12.5亿部,同比增长1.8%,全球PC出货量2.8亿台,同比增长9.1%;受益于国补政策,2025年家电领域行业增长较好,根据国家统计局数据,2025年中国家用电器和音像器材类社会零售总额增长11.0%。与此同时,AI端侧应用正在加速,给手机/PC、可穿戴等硬件产品带来创新和新的机遇,2025年消费电子行业迎来上行周期。

终端产品的升级换代或将带动消费电子领域MEMS传感器芯片、功率器件及模拟IC等的整体增长,同时AI手机及AIPC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求,带动电源管理类芯片形成新场景下的增量需求。

⑤风光储装机规模快速增长,政策助力新能源产业高质量发展

2025年,风光储行业在政策引导与市场需求的双重驱动下,整体保持持续向好的发展态势。国家能源局联合相关部委在报告期内密集出台《分布式光伏发电开发建设管理办法》《新型储能制造业高质量发展行动方案》等一系列新能源产业支持政策,推动新能源产业主导地位不断巩固,为相关产业链的高质量发展创造了良好的外部环境。

根据NE时代统计,2025年公司在国内乘用车功率模块装机量排行榜位列第四。

目前公司SiC MOSFET 芯片及模组已全面覆盖650-3300V碳化硅工艺平台,产品关键指标均处于国内领先水平。根据Yole发布的2025年碳化硅(SiC)业务排名,公司是中国SiC器件厂商中位居第一的企业。2025年公司碳化硅业务实现同比快速增长,跻身全球前五,并占据约5%的全球市场份额。

(3)、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新能源汽车产业深度变革,人工智能技术全面渗透,AI算力规模化爆发与AI应用加速推进,共同催生新技术、新业态、新模式,为经济发展注入新的增长动力。

全球汽车产业持续迈向电动化、智能化、低碳化深水区,产业生态由链式协同,网状协作,向跨领域、全方位深度融合加速演进,新能源汽车与能源网、交通网、信息网三网融合,推动车-路-云一体化协同创新成为方向,8英寸碳化硅工艺平台规模化量产、氮化镓车载电源加速导入,有效提升电驱效率与续航可靠性,物理级AI与智能驾驶深度融合,推动车规级电源管理、传感、驱动芯片向高集成、高可靠、高能效方向迭代;新业态方面,产业链协同持续深化,芯片制造、封测与应用方案加速融合,整车与供应链从单一器件采购转向系统化、一体化解决方案合作;未来,AI(人工智能)全面应用将持续拉高车载算力需求,第三代半导体成为主流技术路线,为公司带来广阔发展机遇。

2025年AI算力需求进入规模化爆发阶段,智算基础设施进入集中升级阶段,能源供给与数据传输成为支撑算力高效运转的两大关键方向。AI数据中心供配电体系持续向高压化、高效化、模块化方向演进,高可靠、大功率供电方案需求快速提升,电源系统架构持续迭代升级。碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料凭借低损耗、高效率的优势,显著提升系统能效与运行稳定性,有力推动功率器件及上游芯片产业创新发展。与此同时,算力互联不断向高速率、低时延、高集成度方向升级,光通信成为破解高带宽传输瓶颈的重要技术路线。MicroLED凭借优异的集成度、低功耗与高速传输特性,逐步由前沿研发迈向产业化预备阶段,为数据中心高速传输领域开辟出新的发展空间。

高端消费领域迎来AI硬件深度普及的新阶段,人工智能由云端向终端全面渗透,智能穿戴、空间交互设备、智能交互玩具等新兴产品快速兴起,终端向轻量化、随身化、沉浸式交互升级,多模态感知、自主交互成为行业重要发展方向,同时具身智能相关产品逐步融入高端消费场景,推动终端形态进一步丰富。技术迭代不断催生新业态、新模式,有力拉动功率、模拟IC、传感器、MCU等核心芯片需求增长,为相关产业带来广阔的发展空间与持续增长动力。

报告期内,基于客户需求,公司系统方案能力迈上加速构筑与落地。公司持续优化和提升经营策略,不断丰富和升级经营模式,进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性,增强公司与客户合作的黏性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	33,180,986,285.55	34,202,723,841.88	-2.99	31,570,366,445.66
归属于上市公司股东的净资产	13,034,362,112.63	12,321,013,873.28	5.79	12,483,074,709.70
营业收入	8,179,732,880.37	6,509,090,845.76	25.67	5,324,482,794.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,889,401,345.88	6,276,082,906.15	25.71	4,910,739,546.44
利润总额	-1,932,576,414.36	-2,246,503,325.61	减亏13.97%	-2,941,428,756.44
归属于上市公司股东的净利润	-594,893,008.06	-962,159,563.25	减亏38.17%	-1,958,331,781.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,118,722,560.11	-1,409,560,221.69	减亏20.63%	-2,261,685,779.13
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2,177,565,829.97	2,145,713,627.83	1.48	925,416,752.03
经营活动产生的现金流量净额	2,134,608,728.19	1,902,620,390.86	12.19	2,614,301,648.62
毛利率(%)	5.51	1.03	增加4.48个百分点	-6.81
净利率(%)	-23.63	-34.51	不适用	-55.24
息税折旧摊销前利润率(%)	26.62	32.96	减少6.34个百分点	17.38
加权平均净资产收益率(%)	-4.95	-7.97	增加3.02个百分点	-22.44
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
研发投入占营业收入的比例(%)	23.76	28.30	减少4.54个百分点	28.72

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,733,684,310.68	1,761,513,459.49	1,926,756,627.44	2,757,778,482.76
归属于上市公司股东的净利润	-182,289,864.64	11,949,489.86	-292,707,251.85	-131,845,381.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-230,213,235.19	-305,394,892.10	-337,641,244.12	-245,473,188.70
经营活动产生的现金流量净额	171,757,565.56	809,667,569.76	-209,109,538.60	1,362,293,131.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	128,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,726

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)		1,152,000,000	13.74	1,152,000,000	无		境内非国有法人
中芯国际控股有限公司		993,600,000	11.85	993,600,000	无		境内非国有法人
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	454,009,900	454,009,900	5.42	454,009,900	无		境内非国有法人
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)		230,400,000	2.75	230,400,000	无		境内非国有法人
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)		216,000,000	2.58	216,000,000	质押	190,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-22,524,011	196,249,363	2.34		无		其他
香港中央结算有限公司	172,720,643	192,668,633	2.3		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,105,887	183,361,707	2.19		无		其他
深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	181,603,960	181,603,960	2.17	181,603,960	无		境内非国有法人
厦门辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)	139,229,702	139,229,702	1.66	139,229,702	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、滨海芯兴与越城基金存在关联关系; 2、硅芯锐、日芯锐存在关联关系; 除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
芯联集成电路制造股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25芯联集成SCP001(科创债)	012582609	2026-07-27	500,000,000	1.6

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用√不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
芯联集成电路制造股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2025年7月30日	AAA	稳定	新增

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.69	41.68	3.01
扣除非经常性损益后净利润	-11.19	-14.10	减亏20.63%
EBITDA全部债务比	19.40	21.03	-1.63
利息保障倍数	-7.22	-5.34	不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入81.80亿元,较上年同期增长25.67%,其中主营业务收入增幅25.71%,保持了良好的增长势头。归属于上市公司股东的净利润为-5.95亿元,实现同比大幅减亏38.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2026-016

芯联集成电路制造股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月11日14点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于2026年度日常性关联交易预计的议案	√
5	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
6.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.02	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

注:本次股东会将听取2025年独立董事述职报告以及公司高级管理人员薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案6.02、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688469	芯联集成	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间:2026年5月7日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二)登记手续:拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

2、联系人:蔺娴婷、赵石昕

联系电话:0575-88421800 传真:0575-88420899

邮政编码:312000 邮箱:IR@unt-cc.com

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于2026年度日常性关联交易预计的议案			
5	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案			
6.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
6.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
6.02	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案			
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2026-007

芯联集成电路制造股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案为拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-594,893,008.06元,其中母公司净利润为1,040,738,398.76元。截至2025年12月31日,合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74元,母公司累计未分配利润为848,630,914.20元。经董事会决议,公司2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,因此本次利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2025年度净利润为负的情况,2025年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定,为了满足经营需要和长远发展规划,保障公司战略发展的顺利实施,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2026-011

芯联集成电路制造股份有限公司
关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____) □其他:
交易品种	商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于黄金、白银、钯、铂、铜等期货品种;外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 20,000 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) 150,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___
交易期限	自董事会审议通过之日至2026年年度董事会召开之日止

- 已履行及拟履行的审议程序

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”或“芯联集成”)于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》,本议案无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司开展的商品期货套期保值和外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,有利于稳定公司的正常生产经营,但商品期货套期保值和外汇衍生品业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,不进行投机交易,有利于提升公司整体防御风险能力,增强财务稳健性。

公司及子公司开展外汇衍生品业务主要为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇使用效率,合理降低财务费用,公司拟根据具体业务情况,通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,能够提高公司利率和汇率波动的能力,增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支付海外供应商的采购款项,并将合理安排资金使用,不会影响公司主营业务的发展。

(二)交易金额

公司及子公司拟进行商品期货套期保值业务及外汇衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过4亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于黄金、白银、钯、铂、铜等期货品种,交易工具优先选择标准期货合约,具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。

公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》,本议案无需提交股东会审议。本次开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务交易风险分析

公司商品期货套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作,可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。

2、资金风险:部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现大幅变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、操作风险:由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会存在因操作失误或流程不完善造成错单,给公司带来损失。

4、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险。

5、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失